

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

## 河南仕佳光子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）												
参与单位名称及人员姓名	建信基金 吕怡、赵荣杰、张文浩、左远明、李登虎、姚波远、杨荔媛、程广飞												
时间	2023年5月22日 10:00-11:00												
地点	公司一楼会议室及腾讯会议												
上市公司接待人员姓名	<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>接待人员职务</th><th>接待人员姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>董事、副总经理</td><td>吴远大</td></tr><tr><td>2</td><td>财务总监、董事会秘书</td><td>赵艳涛</td></tr><tr><td>3</td><td>证券事务代表</td><td>姚俊</td></tr></tbody></table>	序号	接待人员职务	接待人员姓名	1	董事、副总经理	吴远大	2	财务总监、董事会秘书	赵艳涛	3	证券事务代表	姚俊
序号	接待人员职务	接待人员姓名											
1	董事、副总经理	吴远大											
2	财务总监、董事会秘书	赵艳涛											
3	证券事务代表	姚俊											
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司简介</b></p> <p>公司成立于2010年10月，成立之初与中科院半导体所开展院企合作并维持长期良好合作关系。公司聚焦光通信行业，主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块，主要产品包括PLC光分路器系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器、室内光缆、线缆材料等。其中PLC光分路器主要应用于光纤到户；AWG芯片系列产品分为两种，一种是用于骨干网/城域网的DWDM AWG芯片，另一种为数据中心用AWG芯片产品；DFB激光器芯片系列产品主要用于10G PON、4G/5G、数据中心等领域；目前2.5G、10G DFB激光器芯片已批量出货，部分25G DFB激光器正在客户验证中。公司拥有IDM模式“无源+有源”双芯片平台独特优势，目前拥有研发团队200余人。</p>												

## 二、Q&A

### 1、2022 年营收各产品占比如何？

答：主营业务中光芯片及器件的营收占比约 50%，同比增长 21%，室内光缆和线缆材料的营收各占比 25%，与去年基本持平。光芯片及器件中，AWG 芯片系列产品营收占比提升，DFB 激光器系列产品营收占光芯片及器件业务比提升至 10% 以上，PLC 光分路器系列产品占比有所降低，其他基本保持稳定。

### 2、25G DFB 进展情况如何？

答：公司的 2.5G 和 10G DFB 激光器芯片已经批量出货，占据了一定的市场份额，25G DFB 部分波长产品正在客户验证中，有望尽快批量出货。

### 3、未来 DFB 激光器的规划如何？

答：公司于 2016 年启动有源产品的研发，“无源+有源”的光电集成模式是我们公司未来的发展方向和目标。目前聚焦于电信领域和数据中心领域的 DFB、EML 等相关产品正在努力开发中；同时，在硅光用大功率激光器芯片、激光雷达用光源芯片、半导体光放大器等方面也取得显著突破。

### 4、未来 1-2 年，光芯片及器件各产品的增长点在哪里？

答：公司第一季度业绩同比下滑：一方面市场需求下滑，另一方面受疫情影响放缓了市场开拓进度。但长期来看，不管是芯片还是器件及其他产品，我们都积极应对，致力于持续健康成长：在 PLC 光分路产品上，我们新开发了 FTTR 非均分 PLC 光分路器系列产品，在未来是新的增长点；在数据中心用 AWG 芯片系列产品上，高速率替代低速率的趋势明显，公司也相应开发出 200G、400G 及 800G 等应用的配套产品；在电信领域，骨干网用 AWG 已通过国内主要设备商的验证，未来将有一定增长空间；在 DFB 激光器芯片系列产品上，2.5G、10G 的相干产品已批量出货，部分 25G DFB 产品也在客户验证中，有望尽快出货；线缆材料在新能源汽车和充电桩上也有新的应用；除此之外，室内光缆中，公司开发出了 4G/5G 基站拉远光电混合缆。

	<p><b>5、公司属于 IDM 模式，属重资产企业，如何看待？</b></p> <p>答：公司过去几年盈利情况欠佳，主要就是因重大资产折旧费用较高影响，目前无源设备的折旧费用基本已经摊销完毕，未来有源设备折旧费用摊销完毕后，重资产就不再是负担而是优势。另外，公司的 IDM 模式，为我们快速响应客户需求带来了很大的优势。</p> <p><b>6、是否考虑与代工厂合作？</b></p> <p>答：公司属于 IDM 模式，建立了覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的全流程业务体系，目前暂未考虑。</p> <p><b>7、二季度经营情况如何？</b></p> <p>答：公司订单及业绩情况，将遵循信披法规等要求及时披露，请您关注公司公告。未来公司产品的技术研发计划，在补齐现有市场需求产品系列的同时，重点围绕数据中心、骨干网、城域网及接入网等方面研发出具备竞争力的关键芯片及模块，并主动对接、了解客户真实需求，与客户同步开发，实现产品的技术创新，持续研发投入。</p> <p><b>8、全年业绩情况会怎样？</b></p> <p>答：公司一季度受宏观环境、行业发展等因素影响业绩出现下滑，虽然 2022 年通信提供商整体资本开支有所放缓，但该市场的前景仍然比较明朗。2023 年公司制定科学合理的经营增长目标，同时加大内部的降本增效力度，以此提升公司的运营效率和成本管理能力，努力实现 2023 年度经营业绩健康稳定增长。</p>
附件清单(如有)	
日期	2023 年 5 月 22 日